

DIAPOL 508/2 FLUIDA

RESINA PU FLUIDA

CLASE TÉRMICA: B (130°C)

POLIMERIZACIÓN AL AIRE

- ✓ Estabilidad a los agentes químicos
- ✓ Buena estanqueidad
- ✓ Baja contracción al endurecer
- ✓ Endurecimiento rápido
- ✓ Buena adherencia distintos materiales
- ✓ Resistencia al envejecimiento

CAMPO DE APLICACIÓN

Resina de colada bicomponente para múltiples aplicaciones eléctricas y electrónicas (Ej. sellado de circuitos impresos, condensadores, bobinas, reactancias, transformadores, etc.). Las piezas encapsuladas con *Diapol 508/2 FLUIDA* presentan muy buena resistencia química, térmica y mecánica.

MODO DE EMPLEO

La resina homogenizada se puede mezclar con su catalizador a temperatura ambiente, según la dosificación 100/25 en peso. Recomendamos el empleo de máquinas mezcladoras-dosificadoras automáticas. La colada puede hacerse a temperatura ambiente. Para conseguir una mejor calidad de acabado y rapidez recomendamos precalentar la resina a 40 – 50°C. Si se desea desencapsular la resina polimerizada, se debe aplicar nuestro agente desmoldeante de silicona en el molde.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

	DIAPOL 508/2 FLUIDA	CATALIZADOR 500	MEZCLA 100/25
Viscosidad a 25°C (mPa.s)	5000 ± 2000	200 ± 50	3000 ± 500
Densidad a 20°C (g/cm ³)	1.44 ± 0.04	1.22 ± 0.02	1.40 ± 0.04
Pot Life a 25°C (min)		30-45	
Polimerización total		n.d	
Dureza Shore D		75	
Resistencia a la tracción (MPa)		42	
Alargamiento a la rotura (%)		4	
Absorción agua 24h,20°C (% peso)		n.d.	
Rigidez dieléctrica, 50Hz,20°C (KV/mm)		20	
Resistencia superficial (Ohm)		n.d.	
Resistencia específica (Ohm.cm)		n.d.	
Factor de disipación tg,50Hz,20°C		n.d.	
Constante dieléctrica, 50Hz, 20°C		n.d.	
Resis. defor. térmica Pto. Martens (°C)		n.d.	
Conductividad térmica (W/mK)		n.d.	

FORMA DE SUMINISTRO

En envases de hojalata litografiados y precintados de 1, 5 y 25Kg.

Rev. Mayo 2020
Versión: 3